



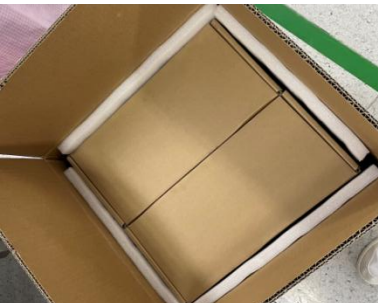
高云的产品变更通知（GPCN）

概述

感谢您使用高云 FPGA 系列器件，此通知的目的是通知受此变更影响的客户注意此次变更，本次变更是为了加强包装的防护。

描述

采用托盘包装的所有产品型号，在包装的内、外盒内增加缓冲泡棉做防护。

变更前	<p>1. 内盒无缓冲泡棉，尺寸为 355*149*90(mm)，如下图：</p>  <p>2. 外箱无缓冲泡棉，尺寸为 385*322*300(mm)，如下图：</p> 
变更后	<p>1. 内盒增加缓冲泡棉，尺寸为 380*178*107(mm)，如下图：</p>  <p>2. 外箱增加缓冲泡棉，尺寸为 407*434*372(mm)，如下图：</p> 

受影响的产品

采用托盘包装的所有产品型号。

关键日期

此次变更与 PCN 生效时间同步，自 2023 年 02 月 15 日开始执行。PCN 执行当日起，产品将会以新旧包装出货，直至变更前物料耗尽。

响应

请客户确认已收到此通知，如对此变更有任何问题或顾虑，请通知我们。如 30 日内没有响应，将默认已接受此变更。

附加文件

无

技术支持与反馈

广东高云半导体科技股份有限公司提供全方位技术支持，在使用过程中如有任何疑问或建议，可直接与公司联系：

网站：www.gowinsemi.com.cn

邮箱：support@gowinsemi.com

版本信息

日期	版本	说明
2023/01/06	1.0	初始版本。
2023/02/08	1.1	更正包装箱尺寸。
2023/02/16	1.2	更改执行说明。

版权所有©2023 广东高云半导体科技股份有限公司

GOWIN高云、Gowin、GowinSynthesis、云源以及高云均为广东高云半导体科技股份有限公司注册商标，本手册中提到的其他任何商标，其所有权利属其所有者所有。未经本公司书面许可，任何单位和个人都不得擅自摘抄、复制、翻译本档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

免责声明

本文档并未授予任何知识产权的许可，并未以明示或暗示，或以禁止发言或其它方式授予任何知识产权许可。除高云半导体在其产品的销售条款和条件中声明的责任之外，高云半导体概不承担任何法律或非法律责任。高云半导体对高云半导体产品的销售和 / 或使用不作任何明示或暗示的担保，包括对产品的特定用途适用性、适销性或对任何专利权、版权或其它知识产权的侵权责任等，均不作担保。高云半导体对文档中包含的文字、图片及其它内容的准确性和完整性不承担任何法律或非法律责任，高云半导体保留修改文档中任何内容的权利，恕不另行通知。高云半导体不承诺对这些文档进行适时的更新。